

(19) 世界知的所有権機関  
国際事務局



(43) 国際公開日  
2002 年 8 月 8 日 (08.08.2002)

PCT

(10) 国際公開番号  
WO 02/061439 A1

- (51) 国際特許分類: G01R 1/067, H01L 21/66
- (21) 国際出願番号: PCT/JP02/00444
- (22) 国際出願日: 2002 年 1 月 22 日 (22.01.2002)
- (25) 国際出願の言語: 日本語
- (26) 国際公開の言語: 日本語
- (30) 優先権データ:
- |                |                               |    |
|----------------|-------------------------------|----|
| 特願 2001-19471  | 2001 年 1 月 29 日 (29.01.2001)  | JP |
| 特願 2001-136192 | 2001 年 5 月 7 日 (07.05.2001)   | JP |
| 特願 2001-237540 | 2001 年 8 月 6 日 (06.08.2001)   | JP |
| 特願 2001-357763 | 2001 年 11 月 22 日 (22.11.2001) | JP |

目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 沼澤 稔之 (NUMAZAWA, Toshiyuki) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 仲前一男 (NAKAMAE, Kazuo) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 岡田 一範 (OKADA, Kazunori) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 依田 潤 (YORITA, Jun) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP).

(74) 代理人: 深見 久郎, 外 (FUKAMI, Hisao et al.); 〒530-0054 大阪府 大阪市 北区南森町 2 丁目 1 番 2 9 号 三井住友銀行南森町ビル 深見特許事務所 Osaka (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 住友電気工業株式会社 (SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒541-0041 大阪府 大阪市 中央区北浜四丁目 5 番 3 3 号 Osaka (JP).

(81) 指定国 (国内): CN, KR, US.

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE, TR).

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 平田 嘉裕 (HIRATA, Yoshihiro) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁目 1 2 番 1 号 住友電気工業株式会社 播磨研究所内 Hyogo (JP). 羽賀 剛 (HAGA, Tsuyoshi) [JP/JP]; 〒678-1205 兵庫県 赤穂郡 上郡町光都 3 丁

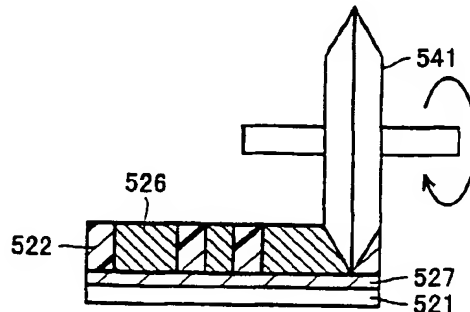
添付公開書類:

— 国際調査報告書

2 文字コード及び他の略語については、定期発行される各 PCT ガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: CONTACT PROBE, METHOD OF MANUFACTURING THE CONTACT PROBE, AND DEVICE AND METHOD FOR INSPECTION

(54) 発明の名称: コンタクトプローブおよびその製造方法ならびに検査装置および検査方法



(57) Abstract: A method of manufacturing a contact probe, comprising an electroforming process for forming a metal layer (526) by performing an electroforming so as to fill clearances in a resist film (522) by using the resist film (522) as a pattern frame having a shape matching the contact probe disposed on a substrate (521), a tip working process for sharpening the area of the metal layer (526) forming the tip end part of the contact probe by diagonally cutting out the area, and a retrieval process for retrieving only the metal layer (526) from the pattern frame.

[続葉有]